

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2024-055

烟台德邦科技股份有限公司

关于参加 2024 年半年度半导体设备及材料专场 集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日(星期四)下午 14:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：线上文字互动
- 说明会问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 16:00 前通过邮箱、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 12 日 14:00-16:00 参加上海证券交易所主办的 2024 年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上文字互动交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年09月12日 下午 14:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心（网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：线上文字互动

三、参加人员

董事长：解海华先生

董事、总经理：陈田安先生

副总经理、董事会秘书、财务总监：于杰先生

独立董事：唐云先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年09月12日 下午 14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年9月11日（星期三）16:00前通过邮件（dbkj@darbond.com）、电话（0535-3467732）等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电话：0535-3467732

邮箱：dbkj@darbond.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司

2024年9月5日